



#1 Coating Technology in The World
Molecule Gradient Layer (MGL)TM Technology

내열 이미드 기재 마스크·반도체 칩 고정용 테이프

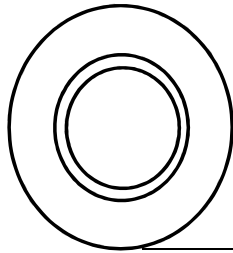
170 시리즈

특징

- ①인두 내열성 폴리 이미드 필름을 기재로 한 내열 테이프
- ②글라스·반도체에 찢이 거의 없이 우수합니다。(171)
- ③경박리성(171)、강점착성(172、174)의 그레이드가 있습니다

용도	171	C-MOS 카메라 모듈용 글라스、C-MOS의 마스크 테이프
	175	C-MOS 카메라 모듈용 글라스、C-MOS의 마스크 테이프
	172	리드 프레임(임시)고정 테이프 (중점착)
	174	리드 프레임(임시)고정 테이프 (강점착)

구조



이형처리 PET필름

실리콘 점착층

기재 (폴리이미드 필름)

특성

일반특성

제품명	(두께) (mm)	(기재두께) (mm)	점착력 (N/25mm)
171	0.065	0.050	0.1
175	0.040	0.025	0.2
172	0.040	0.025	3
174	0.065	0.050	5
KX174(개발품)	0.050	0.025	8

측정조건 인장속도 300mm/min

(JIS Z0237준거) 인장각도 180도

측정온도 23℃

접합 후、24시간 이후 측정 값

피착체 스텐레스 판

제품명	(기재두께) (mm)	인장강도 (MPa)	신율 (%)	절연파괴전압 (KV/mm)
171	0.050	310	80	18
175	0.025	340	60	9
172	0.025	340	60	9
174	0.050	310	80	18
시험조건	C2318	C2318	C2318	C2318

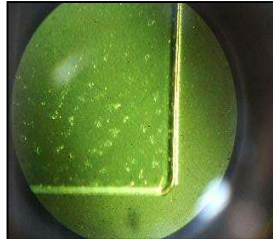
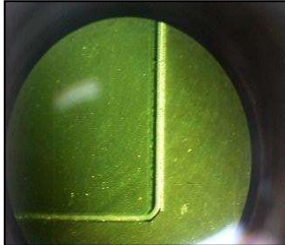
【171·175계】

글라스·반도체·회로 에칭용 내열 마스크

(1) 찢는 성질-1

171

일반 이미드 테이프



조건

글라스에 붙인 후, 250°C 1분 방치

취출 후, 실온 30분 공냉. → 테이프를 박리, 글라스 면을 관찰

(1) 찢는 성질-2

90°CX1hr

150°CX1hr

200°CX1hr



조건

스텐레스 면에 붙인 후, 상기 조건으로 방치

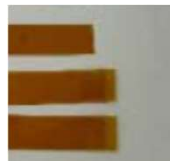
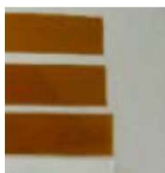
취출 후, 실온 30분 공냉. → 테이프를 박리, 스텐레스 면을 관찰

(2) 내약품성

pH=2의 산성 용액 (H₂SO₄ 수용액) 중에 1분간 침전시킴.

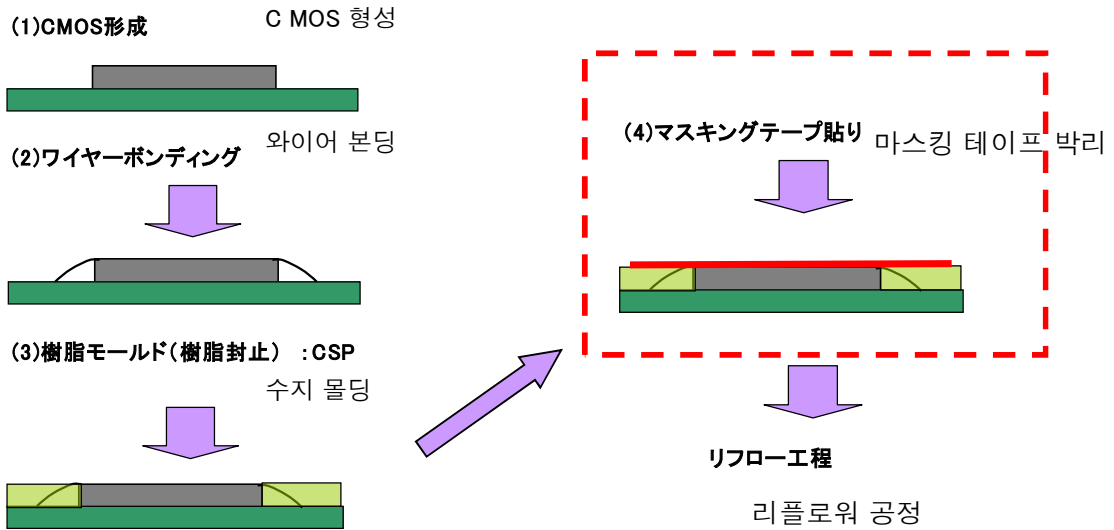
【시험 전】

【시험 후】



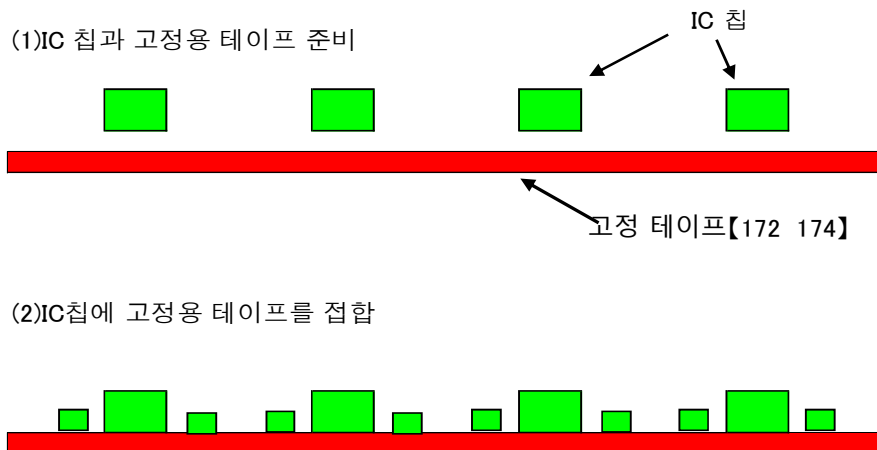
내산성이 좋음.

마스크 공정의 응용 예

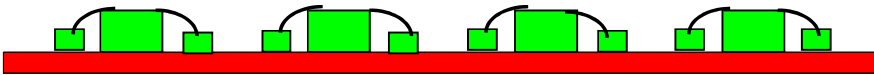


【172·174계】

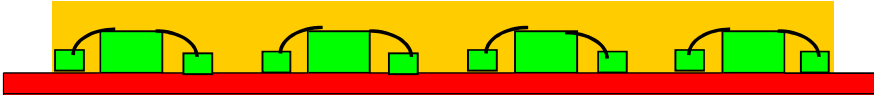
IC 패키지 성형 시 고정 테이프



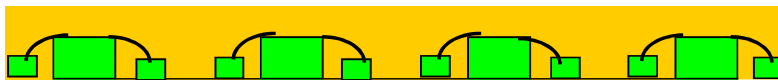
(3)주변 회로 본딩



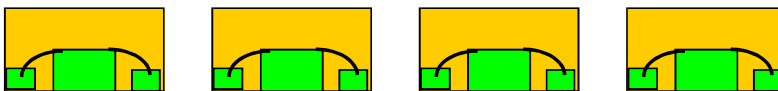
(4)수지 몰딩



(5)테이프 박리

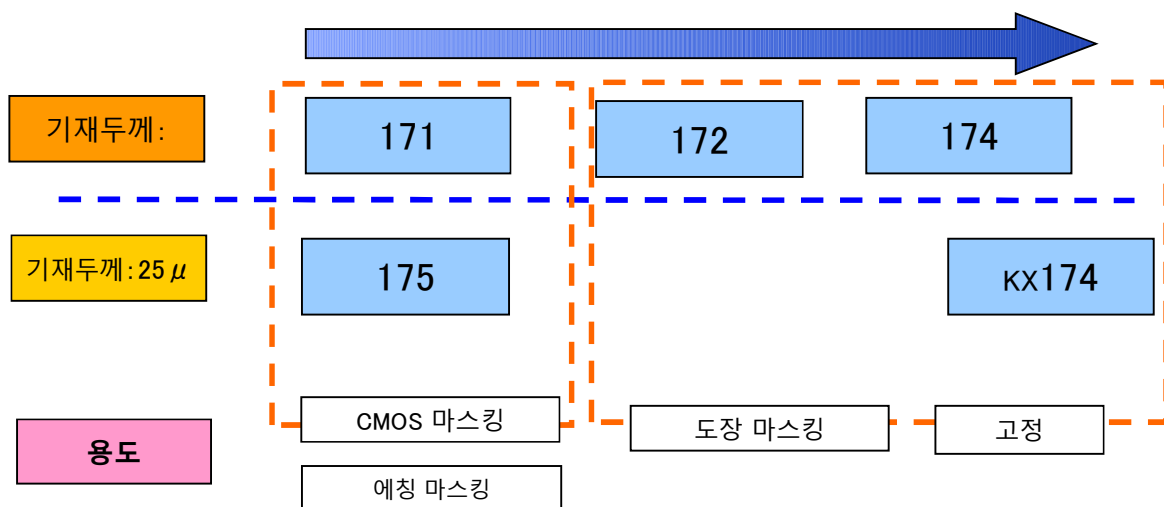


(6)절단·패키징 화



품번 선정

점착	약함	강함
찢 남음	없음	다소있음



사용 상의 주의

- 기술자료는 모두 공동기연화학(주)의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다.
단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변 할 수 있습니다.
따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다.
사용 전에 이 제품이 사용용도·환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.
- 상기 측정은 실온(23℃)하에서 진행된 데이터입니다.저온(5℃이하)의 경우 점착력은 급격히 저하 될 수 있습니다.

보관주의

- 반드시 상자에 넣어 보관하여 주십시오.
- 보관장소는 직사광선이 닿지않는 그늘지역으로 선택하여 주십시오.
특히 고온고습 하의(온도30℃이상 습도50%이상 금지)상태에 방치하지 말아 주십시오.

2010年12月8日 発行

共同技研化学株式会社
〒359-0011
埼玉県所沢市南永井940番地
TEL 04-2944-5151